

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于新产品研发进展的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）首颗 1.8 亿像素全画幅 CMOS 图像传感器（以下简称“CIS”）成功试产。为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将新产品进展情况披露如下：

一、新产品基本情况

随着显示高清化趋势发展，高性能 CIS 的市场需求与日俱增。近期，公司与思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“思特威”）联合推出业内首颗 1.8 亿像素全画幅 CIS。

该产品是公司基于自主研发的 55 纳米工艺平台，携手思特威共同开发光刻拼接技术，克服了在像素列中拼接精度管控以及良率提升等困难，成功突破了在单个芯片尺寸上所能覆盖一个常规光罩的极限，同时确保在纳米级的制造工艺中，拼接后的芯片依然保证电学性能和光学性能的连贯一致。该产品具备 1.8 亿超像素 8K 30fps PixGain HDR 模式高帧率及超高动态范围等多项领先性能，创新优化光学结构，可兼容不同光学镜头，提升产品在终端灵活应用的适配能力，为高端单反相机应用图像传感器提供更多选择，推动全画幅 CIS 进入发展新阶段。

二、新产品研发对公司的影响

1.8 亿像素全画幅 CIS 芯片的成功试产，有助于完善公司在中高阶 CIS 产品的布局，并提升公司产品多元化，促进公司经营持续、健康、稳定发展，有助于填补本土产业空白，促进产业加速升级。未来，公司将继续加大技术研发投入，

全面提升公司的核心竞争力，为更多客户提供更优质服务。

三、相关风险提示

新产品研发取得重大进展到实现大规模量产尚需一定的周期和验证流程，且存在市场环境变化、竞争加剧等因素导致项目效益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024年8月21日